

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于对外投资半导体封装产业项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资半导体封装产业项目的议案》，公司与广州经济技术开发区管理委员会签署了《关于兴森科技半导体封装产业项目投资合作协议》（以下简称“投资合作协议”），具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资半导体封装产业项目的公告》（公告编号：2019-06-029）。根据投资合作协议中的约定，公司需在投资合作协议签订生效之日起三个月内在广州市黄埔区、广州开发区内设立具有独立法人资格的芯片封装基板项目公司，负责该项目的具体运作。现将相关事项进展情况公告如下：

公司与另一投资方国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）双方已就合作条款主要内容达成共识，但尚未签署正式协议，截止目前，由于大基金尚需履行审批程序，待大基金完成审批程序后，双方签署正式协议，随后各出资方共同发起成立芯片封装基板项目公司。现经广州经济技术开发区管理委员会批准同意公司设立芯片封装基板项目公司的时间延期至 2019 年 12 月 31 日。

公司将持续关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日